

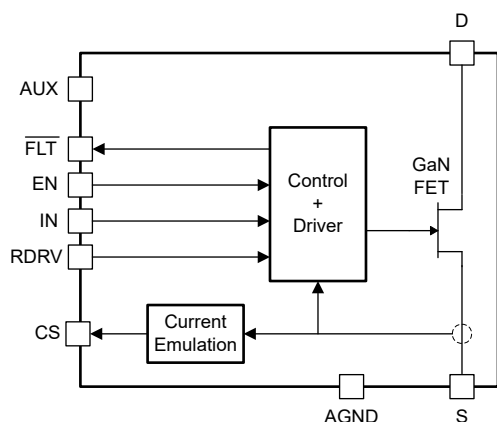
LMG3626 700V、220mΩ GaN FET、ドライバと電流検出エミュレーションを内蔵

1 特長

- GaN パワー FET: 700V、220mΩ、
- 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲートドライバ
- 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
- サイクル単位の過電流保護
- FLT ピン通知付きの過熱保護
- AUX 静止電流: 240μA
- AUX スタンバイ静止電流: 50μA
- 電源および入力ロジックピン最大電圧: 26V
- サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ

2 アプリケーション

- AC/DC アダプタおよびチャージャ
- [モバイル向け充電器の設計](#)
- [USB 電源コンセント](#)
- 補助電源
- [テレビ向け SMPS 電源](#)
- [LED の電源](#)



概略ブロック図

3 説明

LMG3626 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 220mΩ GaN パワー FET です。LMG3626 は、8mm × 5.3mm の VQFN パッケージに GaN FET とゲートドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。

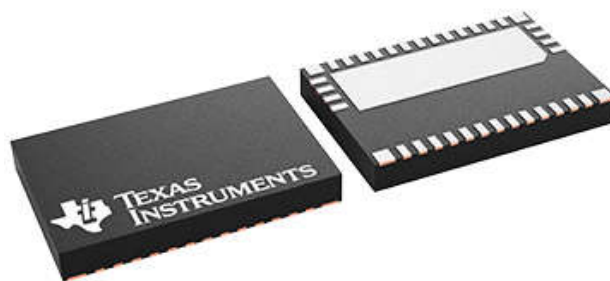
プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。

LMG3626 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープンドレインの FLT ピンで通知されます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
LMG3626	REQ (VQFN, 38)	8mm × 5.3mm

- (1) 詳細については、未定、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。 [セクション 11](#)
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



38 ピン VQFN



目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	14
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	18
3 説明.....	1	8 アプリケーションと実装.....	19
4 ピン構成および機能.....	3	8.1 アプリケーション情報.....	19
5 仕様.....	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	20
5.1 絶対最大定格.....	5	8.3 電源に関する推奨事項.....	22
5.2 ESD 定格.....	5	8.4 レイアウト.....	22
5.3 推奨動作条件.....	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	25
5.4 熱に関する情報.....	6	9.1 ドキュメントのサポート.....	25
5.5 電気的特性.....	7	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	25
5.6 スイッチング特性.....	9	9.3 サポート・リソース.....	25
5.7 代表的特性.....	10	9.4 商標.....	25
6 パラメータ測定情報.....	11	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	25
6.1 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ.....	11	9.6 用語集.....	25
7 詳細説明.....	13	10 改訂履歴.....	25
7.1 概要.....	13	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	26
7.2 機能ブロック図.....	14	11.1 メカニカル データ.....	28

4 ピン構成および機能

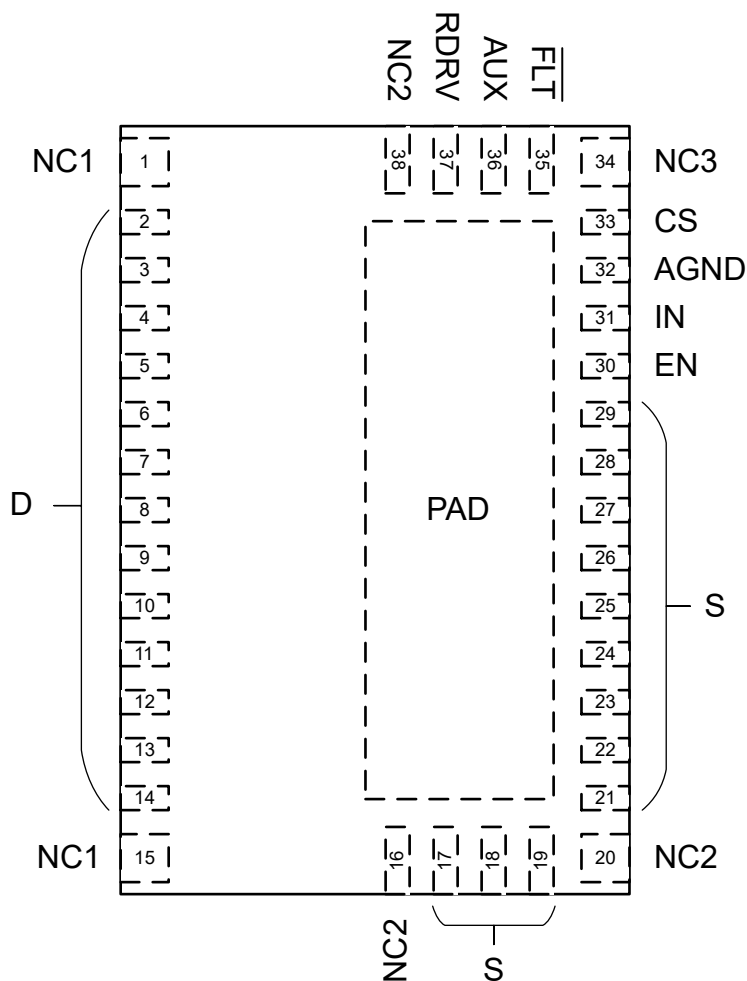


図 4-1. REQ パッケージ、38 ピン VQFN (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
AGND	32	GND	アナログ グランド。S、PAD、NC2 に内部接続されています。
AUX	36	P	補助電圧レール。デバイス電源電圧。AUX と AGND の間にローカル バイパス コンデンサを接続します。
CS	33	O	電流検出エミュレーションの出力。GaN FET 電流のスケーリングされた複製を出力します。出力電流を抵抗に送り、電流センス電圧信号を生成します。抵抗は電源コントローラ IC のローカル グランドを基準にします。この機能は、FET ソースと直列に使用される外部電流センス抵抗を置き換えます。
D	2-14	P	GaN FET のドレイン。NC1 に内部接続されています。
EN	30	I	イネーブル。アクティブ モードとスタンバイモードを切り替えるために使用します。スタンバイ モードは、静止電流を減少して、コンバータの軽負荷効率目標をサポートします。EN から AUX への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、EN が AUX よりも高く駆動される状態が防止されます。
FLT	35	O	アクティブ Low フォルト出力。過熱保護中にアサートされるオープンドレイン出力。
IN	31	I	ゲートドライブ制御入力。IN から AUX への順方向ベースの ESD ダイオードがあるため、IN が AUX よりも高く駆動される状態が防止されます。

表 4-1. ピンの機能 (続き)

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
NC1	1、15	NC	QFN パッケージを PCB にアンカーするために使用します。ピンは、PCB ランディング・パッドに半田付けする必要があります。PCB のランド・パッドは半田なしのマスク定義のパッドであり、PCB 上の他の金属に物理的に接続することはできません。D に内部接続されています。
NC2	16、20、38	NC	QFN パッケージを PCB にアンカーするために使用します。ピンは、PCB ランディング・パッドに半田付けする必要があります。PCB のランド・パッドは半田なしのマスク定義のパッドであり、PCB 上の他の金属に物理的に接続することはできません。AGND、S、PAD に内部接続されています。
NC3	34	NC	QFN パッケージを PCB にアンカーするために使用します。ピンは、PCB ランディング パッドに半田付けする必要があります。PCB のランドディング パッドは半田なしのマスク定義のパッドであり、PCB 上の他の金属に物理的に接続することはできません。ピンは内部接続されていません。
PAD	—	—	サーマル パッド。S、AGND、NC2 に内部接続されています。すべての S 電流は PAD (PAD = S) で伝導できます。
RDRV	37	I	駆動能力制御抵抗。RDRV と AGND の間の抵抗を設定し、GaN FET ターンオン スルーレートをプログラミングします。
S	17-19、21-29	P	GaN FET ソース。AGND、PAD、NC2 に内部接続されています。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、GND = グランド、P = 電源、NC = 接続なし。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

特に記述のない限り: 電圧は AGND を基準にしています⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{DS}	ドレインソース間 (D から S) 電圧、FET オフ ⁽²⁾		700	V
$V_{DS(surge)}$	ドレインソース間 (D から S) 電圧、FET スwitchング、サージ状態 ⁽³⁾		720	V
$V_{DS(tr)(surge)}$	ドレインソース間 (D から S) 過渡リンギング ピーク電圧、FET オフ、サージ状態 ⁽³⁾		800	V
ピン電圧	AUX	-0.3	30	V
	EN, IN, $\overline{FLT}$	-0.3	$V_{AUX} + 0.3$	V
	CS	-0.3	5.5	V
	RDRV	-0.3	4	V
$I_{D(cnts)}$	ドレイン (D から S) 連続電流、FET オン	-4	内部的に制限	A
$I_{D(pulse)(oc)}$	過電流応答時間中のドレイン (D から S) パルス電流 ⁽⁴⁾		10.7	A
$I_{S(cnts)}$	ソース (S から D) 連続電流、FET オフ		4	A
正のシンク電流	CS		10	mA
	$\overline{FLT}$ (アサート時)		内部的に制限	mA
T_J	動作時接合部温度	-40	150	°C
T_{stg}	保存温度	-40	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) GaN パワー FET のスイッチング特性に関する詳細は [セクション 7.3.1](#) セクションを参照してください。(セクション 7.3.1 では $t_1 < 400ns$)。
- (3) [セクション 7.3.1](#) では $t_1 < 100ns$ 。
- (4) 飽和状態になった場合、GaN パワー FET がこの値を自己制限値より低くする可能性があります。

5.2 ESD 定格

				値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM) ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	ピン 1 ～ 15	±1000	V
			ピン 16 ～ 38	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠 ⁽²⁾		±500	V

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

特に記述のない限り、電圧は AGND を基準にしています

			最小値	公称値	最大値	単位
	電源電圧	AUX	10		26	V
	入力電圧	EN、IN	0		V _{AUX}	V
	オープンドレイン出力のプルアップ電圧	FLT	0		V _{AUX}	V
V _{IH}	High レベル入力電圧	EN、IN	2.5			V
V _{IL}	Low レベル入力電圧				0.6	V
I _{D(cnts)}	ドレイン (D から S) 連続電流、FET オン		-3.2		3.2	A
C _{AUX}	外付けバイパスコンデンサから AGND への AUX 容量		0.030			μF
R _{RDRV}	以下のスルーレート設定を構成するための外部スルーレート制御抵抗からの RDRV から AGND への抵抗					
	スルーレート設定 0 (最低速)		90	120	オープン	kΩ
	スルーレート設定 1		42.5	47	51.5	kΩ
	スルーレート設定 2		20	22	24	kΩ
	スルーレート設定 3 (最高速)		0	5.6	11	kΩ

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		REQ (VQFN)	単位
		38 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	27	$^{\circ}C/W$
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	2.13	$^{\circ}C/W$

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

1) シンボルの定義: I_D = D から S への電流、 I_S = S から D への電流、 $I_{CS(src)}$ = CS からの電流、2) 特に記述のない限り、電圧、抵抗、容量は AGND を基準、 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DS} = 520\text{V}$ 、 $10\text{V} \leq V_{AUX} \leq 26\text{V}$ 、 $V_{EN} = 5\text{V}$ 、 $V_{IN} = 0\text{V}$ 、 $R_{DRV} = 0\Omega$ 、 $R_{CS} = 100\Omega$

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
GaN パワー FET						
$R_{DS(on)}$	ドレイン ソース間 (D から S) オン抵抗	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $I_D = 1.9\text{A}$ 、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		220	308	mΩ
		$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $I_D = 1.9\text{A}$ 、 $T_J = 125^{\circ}\text{C}$		390		
I_{DSS}	ドレイン (D から S) リーク電流	$V_{DS} = 650\text{V}$ 、 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		1.3		μA
		$V_{DS} = 650\text{V}$ 、 $T_J = 125^{\circ}\text{C}$		7		
Q_{OSS}	出力 (D から S) 充電	$V_{DS} = 400\text{V}$		14		nC
C_{OSS}	出力 (D から S) 容量			22.1		pF
E_{OSS}	出力 (D から S) 容量に蓄積されたエネルギー			2		μJ
$C_{OSS,er}$	エネルギー関連の実効出力 (D から S) 容量			24.5		pF
$C_{OSS,tr}$	時間関連の実効出力 (D から S) 容量	$V_{DS} = 0\text{V} \sim 400\text{V}$		34.4		pF
Q_{RR}	逆方向回復電荷			0		nC
過電流保護						
$I_{T(OC)}$	過電流フォルト – スレッショルド電流		3.2	3.6	4	A
CS						
	電流センス ゲイン ($I_{CS(src)} / I_D$)	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $0\text{V} \leq V_{CS} \leq 2\text{V}$ 、 $0\text{A} \leq I_D < I_{T(OC)}$		1.633		mA/A
	電流センス入力オフセット電流	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $0\text{V} \leq V_{CS} \leq 2\text{V}$ 、 $0\text{A} \leq I_D < I_{T(OC)}$	-30		30	mA
	IN が High のままである間、過電流フォルトが発生した後に初期出力を保持	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $0\text{V} \leq V_{CS} \leq 2\text{V}$			7	mA
$I_{CS(src)}(OC)(final)$	IN が High のままである間、過電流フォルトが発生した後に最終出力を保持	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $0\text{V} \leq V_{CS} \leq 2\text{V}$	10	12	15.5	mA
	出力クランプ電圧	$V_{IN} = 5\text{V}$ 、 $I_D = 3.1\text{A}$ 、外部ソースからの 5mA CS シンク		2.55		V
EN、IN						
V_{IT+}	正方向入力スレッショルド電圧		1.7		2.45	V
V_{IT-}	負方向入力スレッショルド電圧		0.7		1.3	V
	入力スレッショルド電圧のヒステリシス			1		V
	ブルダウン入力抵抗	$0\text{V} \leq V_{PIN} \leq 3\text{V}$	200	400	600	kΩ
	ブルダウン入力電流	$10\text{V} \leq V_{PIN} \leq 26\text{V}$ 、 $V_{AUX} = 26\text{V}$		10		μA
過熱保護						
	温度フォルト – 正方向スレッショルド温度		145	165		°C
	温度フォルト – 負方向スレッショルド温度			145		°C
	温度フォルト – スレッショルド温度ヒステリシス			20		°C
FLT						
	Low レベル出力電圧	アサート時の 1mA の $\overline{\text{FLT}}$ シンク			200	mV
	オフ状態のシンク電流	$V_{FLT} = V_{AUX}$ 、アサート解除時			1	μA
AUX						
$V_{AUX,T+}(UVLO)$	UVLO – 正方向のスレッショルド電圧		8.9	9.3	9.7	V
	UVLO – 負方向のスレッショルド電圧		8.6	9.0	9.4	V
	UVLO – スレッショルド電圧ヒステリシス			250		mV

5.5 電気的特性 (続き)

1) シンボルの定義: I_D = D から S への電流、 I_S = S から D への電流、 $I_{CS(src)}$ = CS からの電流、2) 特に記述のない限り、電圧、抵抗、容量は AGND を基準、 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DS} = 520\text{V}$ 、 $10\text{V} \leq V_{AUX} \leq 26\text{V}$ 、 $V_{EN} = 5\text{V}$ 、 $V_{IN} = 0\text{V}$ 、 $R_{DRV} = 0\Omega$ 、 $R_{CS} = 100\Omega$

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
	スタンバイ時の静止電流	$V_{EN} = 0\text{V}$		50	80	μA
	静止電流			240	360	μA
	動作電流	$V_{IN} = 0\text{V}$ または 5V 、 $V_{DS} = 0\text{V}$ 、 $I_D = 0\text{A}$ 、 $f_{IN} = 500\text{kHz}$		1.5		mA

5.6 スイッチング特性

1) シンボルの定義: I_D = D から S への電流、 I_S = S から D への電流、 $I_{CS(src)}$ = CS からの電流、2) 特に記述のない限り、電圧、抵抗、容量は AGND を基準、 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{DS} = 520\text{V}$ 、 $10\text{V} \leq V_{AUX} \leq 26\text{V}$ 、 $V_{EN} = 5\text{V}$ 、 $V_{IN} = 0\text{V}$ 、 $R_{RDRV} = 0\Omega$ 、 $R_{CS} = 100\Omega$

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
GaN パワー FET						
$t_{d(ON)}$ (I_{DRAIN})	ドレイン電流のターンオン遅延時間	LMG3626、 $V_{IN} > V_{IN,IT+}$ から $I_D > 25mA$ まで、 $V_{BUS} = 400V$ 、 L_{HB} 電流 = 1A、以下のスルーレート設定の場合、『 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ 』を参照				
		スルーレート設定 0 (最低速)		77		ns
		スルーレート設定 1		34		
		スルーレート設定 2		28		
		スルーレート設定 3 (最高速)		23		
$t_{d(ON)}$	ターンオン遅延時間	LMG3626、 $V_{IN} > V_{IN,IT+}$ から $V_{DS} < 320V$ まで、 $V_{BUS} = 400V$ 、 L_{HB} 電流 = 1A、以下のスルーレート設定の場合、『 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ 』を参照				
		スルーレート設定 0 (最低速)		97		ns
		スルーレート設定 1		44		
		スルーレート設定 2		35		
		スルーレート設定 3 (最高速)		26		
$t_{d(OFF)}$	ターンオフ遅延時間	$V_{IN} < V_{IN,IT-}$ から $V_{DS} > 80V$ まで、 $V_{BUS} = 400V$ 、 L_{HB} 電流 = 1A、(スルーレート設定に依存しない)、『 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ 』を参照		32		ns
$t_f(OFF)$	ターンオフ立ち下がり時間	$V_{DS} > 80V$ から $V_{DS} > 320V$ まで、 $V_{BUS} = 400V$ 、 L_{HB} 電流 = 1A、(スルーレート設定に依存しない)、『 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ 』を参照		24		ns
	ターンオンのスルーレート	LMG3626、 $V_{DS} < 250V$ から $V_{DS} < 150V$ まで、 $T_J = 25^{\circ}C$ 、 $V_{BUS} = 400V$ 、 L_{HB} 電流 = 1A、以下のスルーレート設定の場合、『 GaN パワー FET のスイッチング パラメータ 』を参照				
		スルーレート設定 0 (最低速)		20		V/ns
		スルーレート設定 1		50		
		スルーレート設定 2		75		
		スルーレート設定 3 (最高速)		150		
CS						
t_r	立ち上がり時間	$I_{CS(SRC)} > 0.2 \times I_{CS(SRC)(FINAL)}$ から $I_{CS(SRC)} > 0.9 \times I_{CS(SRC)(FINAL)}$ まで、 $0V \leq V_{CS} \leq 2V$ 、1A 負荷イネーブル			35	ns
EN						
	EN ウェークアップ時間	$V_{EN} > V_{IT+}$ から $I_{D(IS)} > 10mA$ まで、 $V_{INL} = 5V$		1.5		μs

5.7 代表的特性

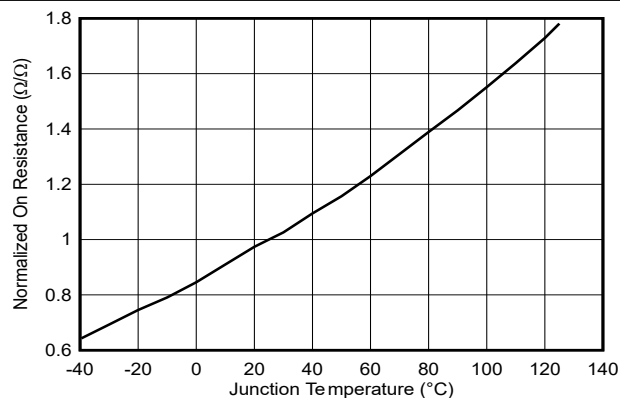


図 5-1. 接合部温度と正規化オン抵抗との関係

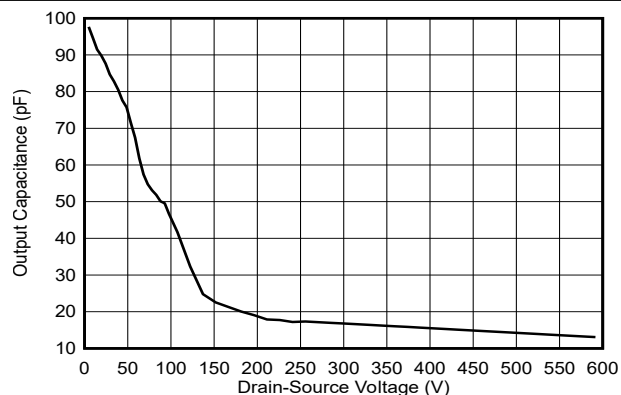


図 5-2. 出力キャパシタンスとドレインソース間電圧との関係

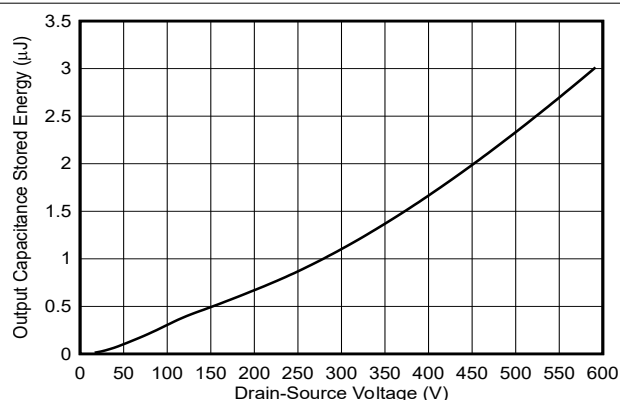


図 5-3. 出力キャパシタンスに蓄積されたエネルギーとドレインソース間電圧との関係

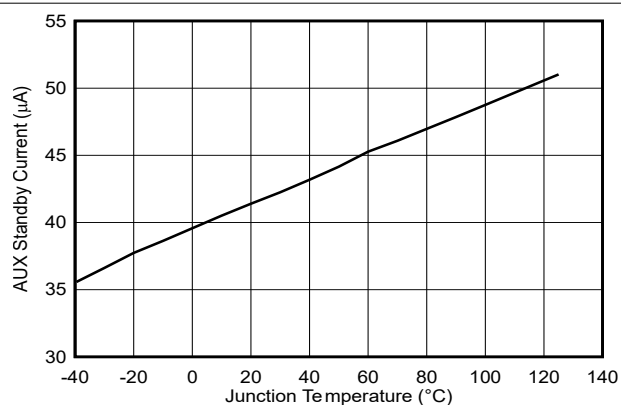


図 5-4. AUX スタンバイ電流と接合部温度との関係

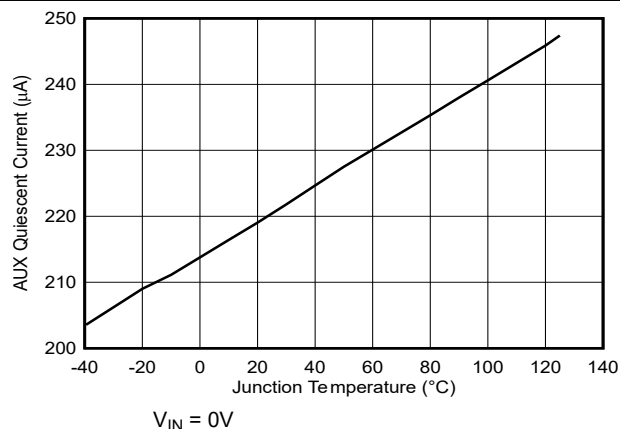


図 5-5. AUX 静止電流と接合部温度との関係

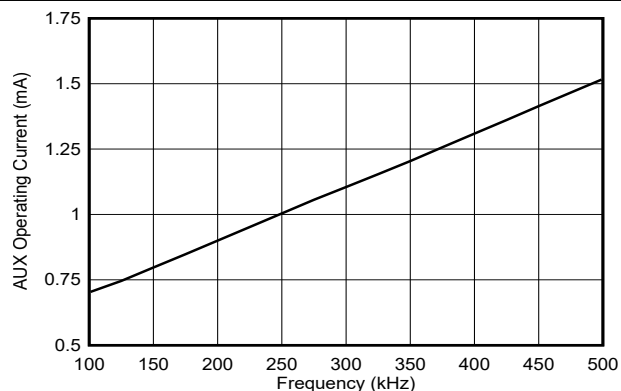


図 5-6. AUX の動作電流と周波数との関係

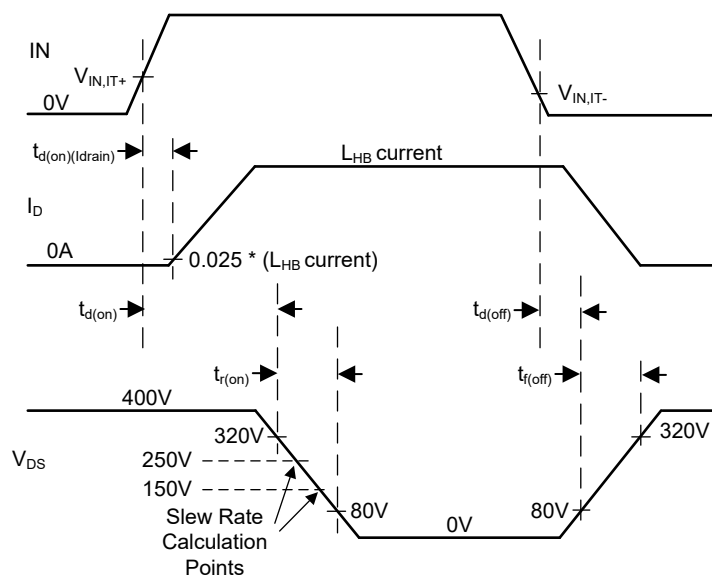


図 6-2. GaN パワー FET のスイッチング パラメータ

7 詳細説明

7.1 概要

LMG3626 は、スイッチング パワー コンバータで使用することを目的とした内蔵 700V 220mΩ GaN パワー FET です。LMG3626 は、8mm x 5.3mm の QFN パッケージに、GaN FET、ゲートドライバ、電流検出エミュレーション機能、保護機能が組み合わされています。

700V 定格の GaN FET は、オフライン パワー スwitchング アプリケーションで発生する高電圧に対応します。GaN FET の低出力容量電荷は、パワー コンバータのスイッチングに必要な時間とエネルギーの両方を削減します。これは、小型で高効率のパワー コンバータ設計に必要とされる重要な特性です。

LMG3626 内部ゲートドライバは、駆動電圧を制御して、GaN FET のオン抵抗を最適化します。内部ドライバは総ゲートインダクタンスと GaN FET のコモンモード インダクタンスを低減し、コモンモード過渡耐性 (CMTI) などのスイッチング性能を向上させます。GaN FET のターンオン スルーレートを 4 つのディスクリート設定のいずれかに個別にプログラムすることで、電力損失、スイッチング起因するにリンギング、EMI に関する設計の柔軟性を実現します。

電流検出エミュレーションにより、CS ピンの出力に GaN FET ドレイン電流を複製します。CS ピンは、AGND への抵抗で終端され、外部電源コントローラへの電流センス入力信号を生成します。この CS ピン抵抗は、従来の電流センス抵抗を GaN FET ソースと直列に接続したものに置き換え、消費電力と占有面積を大幅に削減します。さらに、GaN FET ソースと直列に電流センス抵抗を接続していない場合、GaN FET のサーマル パッドを PCB の電源グランドに直接接続してください。このサーマル パッド接続では、システムの熱性能が向上しているほか、サーマル パッドでデバイスの全電流を通すことができるため、デバイス配線の柔軟性がさらに向上します。

AUX 入力電源の電圧範囲は広いので、電源コントローラによって生成される広範囲の電源レールに適合します。AUX の静止電流が小さいため、政府の軽負荷効率要件を満たすうえで不可欠なコンバータ バースト モード動作に対応できます。EN ピンを使用してデバイスをスタンバイ モードにすると、AUX 静止電流をさらに低減できます。

IN および EN 制御ピンは、高入力インピーダンスおよび低入力スレッショルド電圧で、最大入力電圧が AUX 電圧と同じです。この組み合わせにより、このピンは、低電圧と高電圧の両方の入力信号に対応し、低電力出力で駆動できます。

LMG3626 の保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープンドレイン FLT 出力で報告されます。

7.2 機能ブロック図

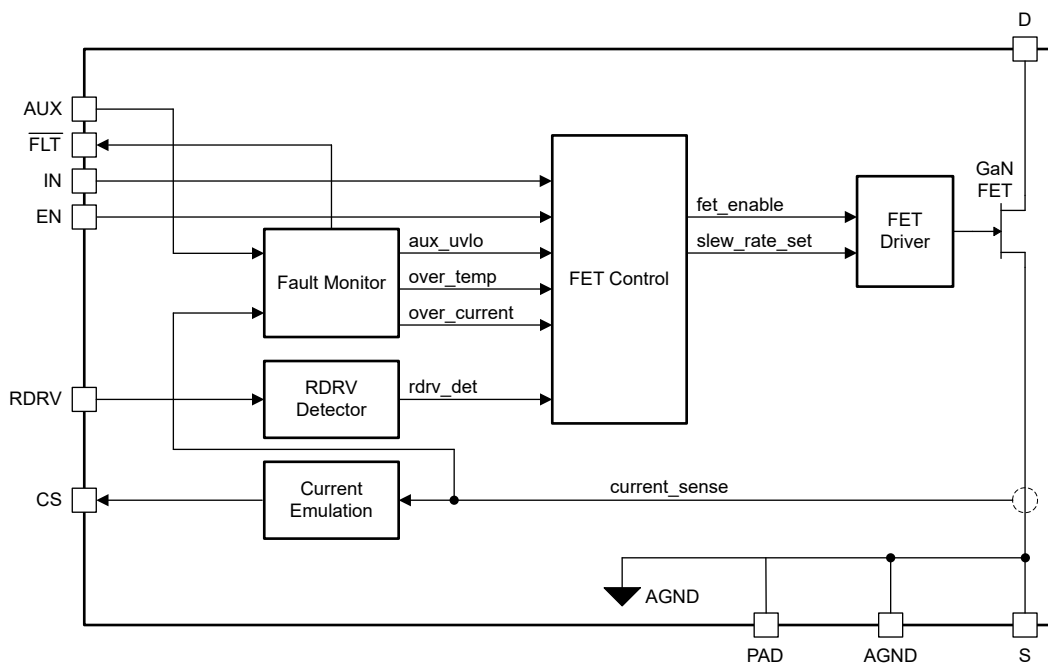


図 7-1. 機能ブロック図

7.3 機能説明

7.3.1 GaN パワー FET のスイッチング機能

シリコン FET が長きにわたって支配的なパワースイッチ技術であったため、多くの設計者は、ドレインソース間電圧の銘板を、異なる技術のデバイスを比較する際の等価点として使用できないことを知りません。シリコン FET の銘板のドレインソース間電圧は、アバランシェ ブレークダウン電圧によって設定されます。GaN FET の銘板のドレインソース間電圧は、データシートの仕様への長期的な準拠によって設定されます。

シリコン FET の銘板のドレインソース間電圧を超えると、即座に永続的な損傷を引き起こすおそれがあります。一方、GaN FET のブレークダウン電圧は銘板のドレインソース間の見出し電圧よりもはるかに高くなっています。たとえば、LMG3626 GaN パワー FET のブレークダウンドレイン ソース間電圧は 800V を上回るため、LMG3626 は同じ銘板の定格を持つシリコン FET を超える条件下で動作できます。

図 7-2 を使用して、LMG3626 GaN パワー FET のスイッチング機能を説明します。図に、スイッチング アプリケーション内の異なる 4 つのスイッチ サイクルについて、LMG3626 GaN パワー FET のドレイン ソース間電圧と時間との関係を示します。スイッチング周波数またはデューティ・サイクルに関する請求は行われません。最初の 3 サイクルは通常動作を示し、最後のサイクルはまれな入力電圧サージ時の動作を示しています。LMG3626 GaN パワー FET は、連続導通モード (CCM) のハード スwitchング、ゼロ電圧スイッチング (ZVS)、不連続導通モード (DCM) のスイッチング条件でオンにできます。

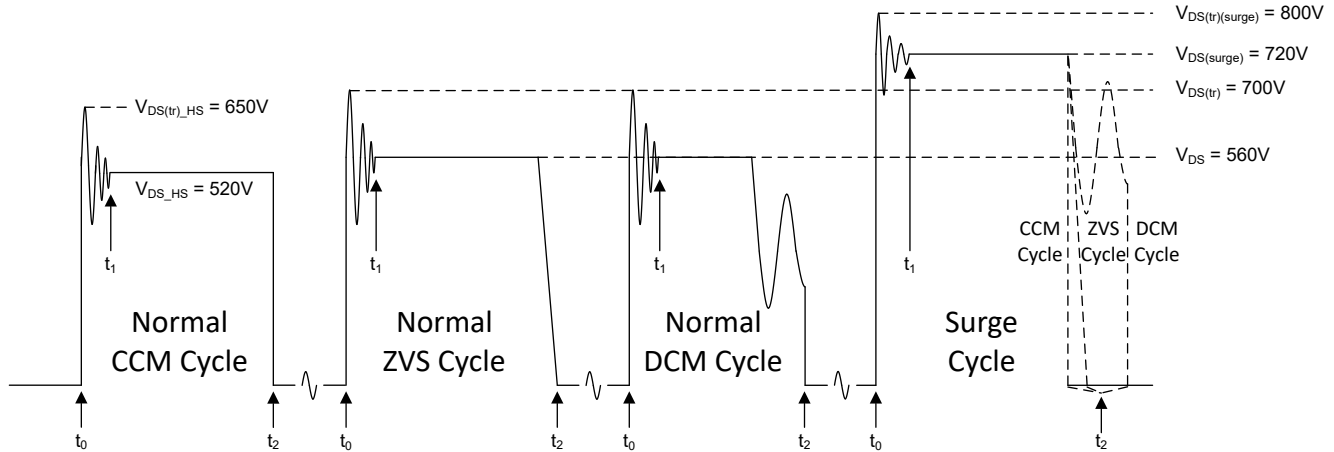


図 7-2. GaN パワー FET のスイッチング機能

各サイクルは t_0 より先に開始し、FET がオン状態になります。 t_0 の時点で GaN FET はターンオフし、寄生素子によってドレインソース間電圧に高周波でリングングが生じます。高周波リングングは、 t_1 だけ減衰します。 t_1 と t_2 の間で、スイッチングアプリケーションの特性応答により、FET のドレインソース間電圧が決まります。特性はフラットライン (プラトー) として表示されますが、他の応答も可能です。 t_2 の時点で、GaN FET がオンになります。通常の CCM 動作の場合、過渡リングングの電圧制限は 650V、プラトーの電圧制限は 520V です。通常の ZVS/DCM 動作の場合、過渡リングングの電圧制限は 700V、プラトーの電圧制限は 560V です。まれなサージイベントの場合、過渡リングングの電圧制限は 800V、プラトーの電圧制限は 720V です。

7.3.2 ターンオン スルーレート制御

GaN パワー FET ターンオン スルーレートは、RDRV ピンと AGND ピンの間の抵抗により、4 つのディスクリート設定のいずれかにプログラミングされます。スルーレートの設定は、AUX 電源オン中に AUX 電圧が AUX パワーオン リセット電圧を 1 回上回ると決まります。スルーレート設定の決定時間は指定されていませんが、約 0.4 μ s です。

スルーレートの設定 に、4 つのスルーレート設定の推奨プログラミング抵抗値 (標準値)、および各設定でのターンオン スルーレートの標準値を示します。表に記載されているように、スルーレート設定 0 のプログラムでは開回路接続が許容され、スルーレート設定 3 のプログラムでは短絡接続 (RDRV を AGND に短絡) が許容されます。

表 7-1. スルーレートの設定

ターンオン スルーレートの設定	推奨標準プログラミング抵抗値 (k Ω)	標準ターンオン スルーレート (V/ns)	備考
0 (最低速)	120	LMG3626: 20	プログラミング抵抗の開回路接続は許容されます。
1	47	LMG3626: 50	
2	22	LMG3626: 75	
3 (最高速)	5.6	LMG3626: 150	プログラミング抵抗 (RDRV を AGND に短絡) の短絡接続は許容されます。

7.3.3 電流検出エミュレーション

電流検出エミュレーション機能により、CS ピンの出力にある GaN パワー FET の正のドレイン電流をスケールリングして複製します。電流検出エミュレーションのゲイン G_{CSE} は、ローサイド GaN パワー FET I_D のドレインに 1A が流れるごとの CS ピン I_{CS} からの 1.633mA 出力です。

$$G_{CSE} = I_{CS} \div I_D = 1.633\text{mA} \div 1\text{A} = 0.001633 \quad (1)$$

CS ピンは、AGND への抵抗 R_{CS} で終端し、外部電源コントローラへの電流センス電圧入力信号を生成します。

R_{CS} は従来の電流センス設計抵抗 $R_{CS(trad)}$ を求め、 G_{CSE} の逆数を乗算して決定されます。従来の電流センス設計では、GaN パワー FET のドレイン電流 I_D を $R_{CS(trad)}$ 経由で渡すことで、電流センス電圧 $V_{CS(trad)}$ が生成されます。LMG3626 は、CS ピンの出力電流 I_{CS} を R_{CS} 経由で渡すことで、電流センス電圧 V_{CS} を生成します。どちらの設計でも、電流センス電圧が同じであることを確認します。

$$V_{CS} = I_{CS} \times R_{CS} = V_{CS(trad)} = I_D \times R_{CS(trad)} \quad (2)$$

$$R_{CS} = I_D \div I_{CS} \times R_{CS(trad)} = 1 \div G_{CSE} \times R_{CS(trad)} \quad (3)$$

$$R_{CS} = 612 \times R_{CS(trad)} \quad (4)$$

CS ピンは、内部で標準値 2.55V にクランプされます。このクランプは、例えば CS ピンの電流センス抵抗が断線した場合などに、電源コントローラの脆弱な電流センス入力ピンを過電圧から保護します。

図 7-3 に、電流センス エミュレーションの動作を示します。どちらのサイクルでも、GaN FET が有効化されている間の CS ピン電流によって GaN パワー FET のドレイン電流がエミュレートされます。最初のサイクルは、電流センスの入力スレッシュホールドがトリップされたときに、コントローラが GaN パワー FET をオフにする通常動作を示しています。2 番目のサイクルは、コントローラの電流センス入力スレッシュホールドがトリップされる前に、LMG3626 の過電流保護が GaN パワー FET をオフにするフォルト状態を示しています。この 2 番目のサイクルでは、LMG3626 は、高速ランプによる人工的な電流検出エミュレーション信号を生成してコントローラの電流センス入力スレッシュホールドをトリップすることで、コントローラの IN パルスのハングを回避します。人工信号は、IN ピンがロジック Low になるまで保持されます。このロジック Low は、コントローラがスイッチ動作の制御を再確立したことを示します。

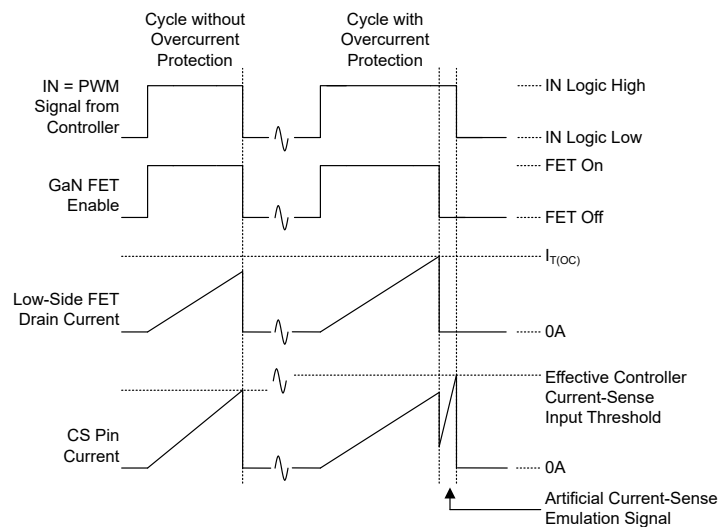


図 7-3. 電流検出エミュレーションの動作

7.3.4 入力制御ピン (EN、IN)

EN ピンは、セクション 7.4 に記載されているアクティブ モードとスタンバイ モードの間でデバイスを切り替えるために使用します。

IN ピンを使用して、GaN パワー FET のオン/オフを切り替えます。

入力制御ピンがあり、ノイズ耐性のため、標準値 1V の入力電圧スレッシュホールド ヒステリシスがあります。400kΩ は、公称入力電圧が 4V を超えると飽和して、最大入力プルダウン電流を標準値 10μA に制限します。

以下の条件により、IN ターンオンアクションがブロックされます。

- スタンバイ モード (上記の EN ピンで設定される通り)
- AUX UVLO

- 過電流保護
- 過熱保護

スタンバイ モード、AUX UVLO、過熱保護は、IN ロジック状態とは無関係です。図 7-4 に、IN 独立ブロッキング動作を示します。

過電流保護は、IN が GaN パワー FET をオンにした後にのみ動作します。詳細については、セクション 7.3.6 を参照してください。

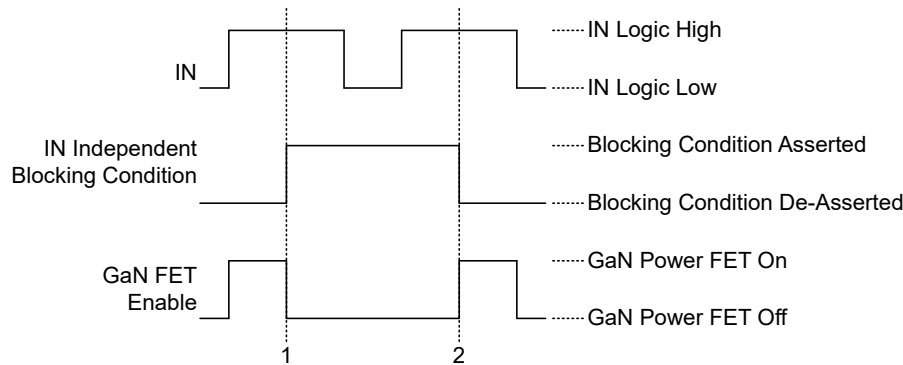


図 7-4. IN 独立ブロッキング状態動作

7.3.5 AUX 電源ピン

AUX ピンは、内部回路の入力電源です。

7.3.5.1 AUX パワーオン リセット

AUX 電圧が AUX パワーオンリセット電圧を下回ると、AUX パワーオンリセットによりすべてのローサイド機能が無効化されます。AUX パワーオン リセット電圧は指定されていませんが、約 5V です。AUX 電圧が AUX パワーオン リセット電圧を上回ると、AUX パワーオン リセットにより、RDRV ピンにプログラミングされるローサイド スルーレート設定の 1 回限りの判定が初期化されます。AUX 電圧が AUX パワーオン リセット電圧を上回ると、AUX パワーオン リセットにより、過熱保護機能が有効化されます。

7.3.5.2 AUX 低電圧誤動作防止 (UVLO)

AUX 電圧が AUX UVLO 電圧を下回ると、AUX UVLO は GaN パワー FET をオフに保持します。図 7-4 に、AUX UVLO ホールドオフ(ブロッキング動作)を示します。AUX UVLO 電圧 ヒステリシスは、UVLO 電圧トリップ ポイント付近でのオン/オフのチャタリングを防止します。

7.3.6 過電流保護

LMG3626 は、GaN パワー FET のサイクル単位の過電流保護を実装しています。図 7-5 に、サイクル単位の過電流動作を示します。IN ロジック High サイクルのたびに、GaN パワー FET がオンになります。GaN パワー FET のドレイン電流が過電流スレッショルド電流を超えると、過電流保護によって IN ロジック High 期間の残りの部分で GaN パワー FET がオフになります。

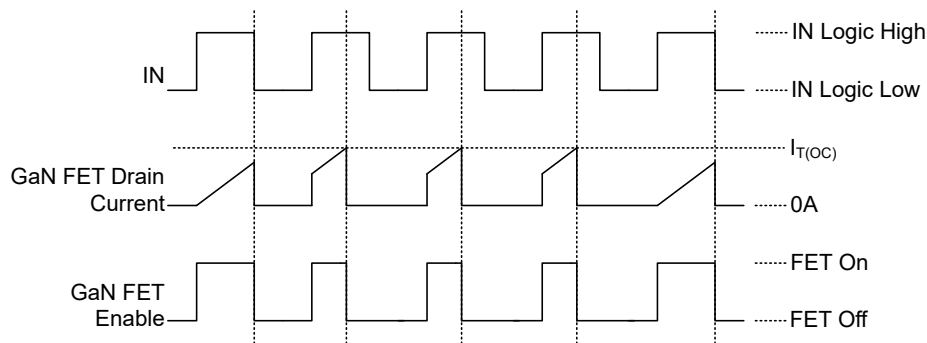


図 7-5. サイクル単位の過電流保護動作

$\overline{\text{FLT}}$ ピンでは、過電流保護イベントは通知されません。サイクル単位の過電流保護では、イベントが報告されず、保護によって GaN パワー FET が IN サイクルごとにオンになるため、システムの中断が最小限に抑えられます。

コントローラがハング状態に陥るのを防ぐため、ローサイド過電流保護はローサイド GaN パワー FET をオフにし、[セクション 7.3.3](#) に記載されているように人工的な CS ピン電流を生成します。

7.3.7 過熱保護

LMG3626 の温度が過熱保護温度を超えると、過熱保護機能によって GaN パワー FET の動作が停止します。[図 7-4](#) に、過熱保護のホールドオフ (ブロッキング) 動作を示します。過熱保護ヒステリシスにより、誤った熱サイクルが防止されます。

過熱保護がアサートされると、 $\overline{\text{FLT}}$ ピンで過熱フォルトが通知されます。加熱故障は、 $\overline{\text{FLT}}$ ピンで通知される唯一のフォルトイベントです。AUX 電圧が AUX パワーオン リセット電圧を上回ると、過熱保護が有効になります。AUX パワーオン リセット電圧が低いため、アプリケーションの冷却フェーズ中に AUX レールがドループした場合でも、過熱保護が動作し続けることができます。

7.3.8 障害通知

LMG3626 は、過熱フォルトのみを通知します。過熱保護機能がアサートされると、 $\overline{\text{FLT}}$ ピンで過熱フォルトが通知されます。 $\overline{\text{FLT}}$ ピンはアクティブ Low のオープンドレイン出力であり、過熱フォルトが発生するとピンは Low にプルされます。

7.4 デバイスの機能モード

LMG3626 には、EN ピンで制御される 2 つの動作モードがあります。デバイスは、EN がロジック High のときはアクティブ モード、EN ピンがロジック Low のときはスタンバイ モードになります。アクティブモードでは、IN ピンによってパワー FET が制御されます。スタンバイ モードでは、IN ピンは無視され、GaN パワー FET はオフ状態に保持され、AUX の静止電流は AUX スタンバイ静止電流まで減少します。

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 アプリケーション情報

LMG3626 を使用すると、スイッチ モード電源アプリケーションに、GaN FET 技術を簡単に採用できます。内蔵ゲートドライバ、低 I_{IN} 入力スレッショルド電圧、広い補助入力電源電圧により LMG3626 一般的な業界電源コントローラとシームレスに組み合わせられます。電流検出エミュレーション機能により、電力が削減され、熱伝導が改善されます。

LMG3626 を使用するには、プログラミング抵抗を使用して目標のターンオン スルーレートを設定し、電流センス抵抗を計算するだけです。

8.2 代表的なアプリケーション

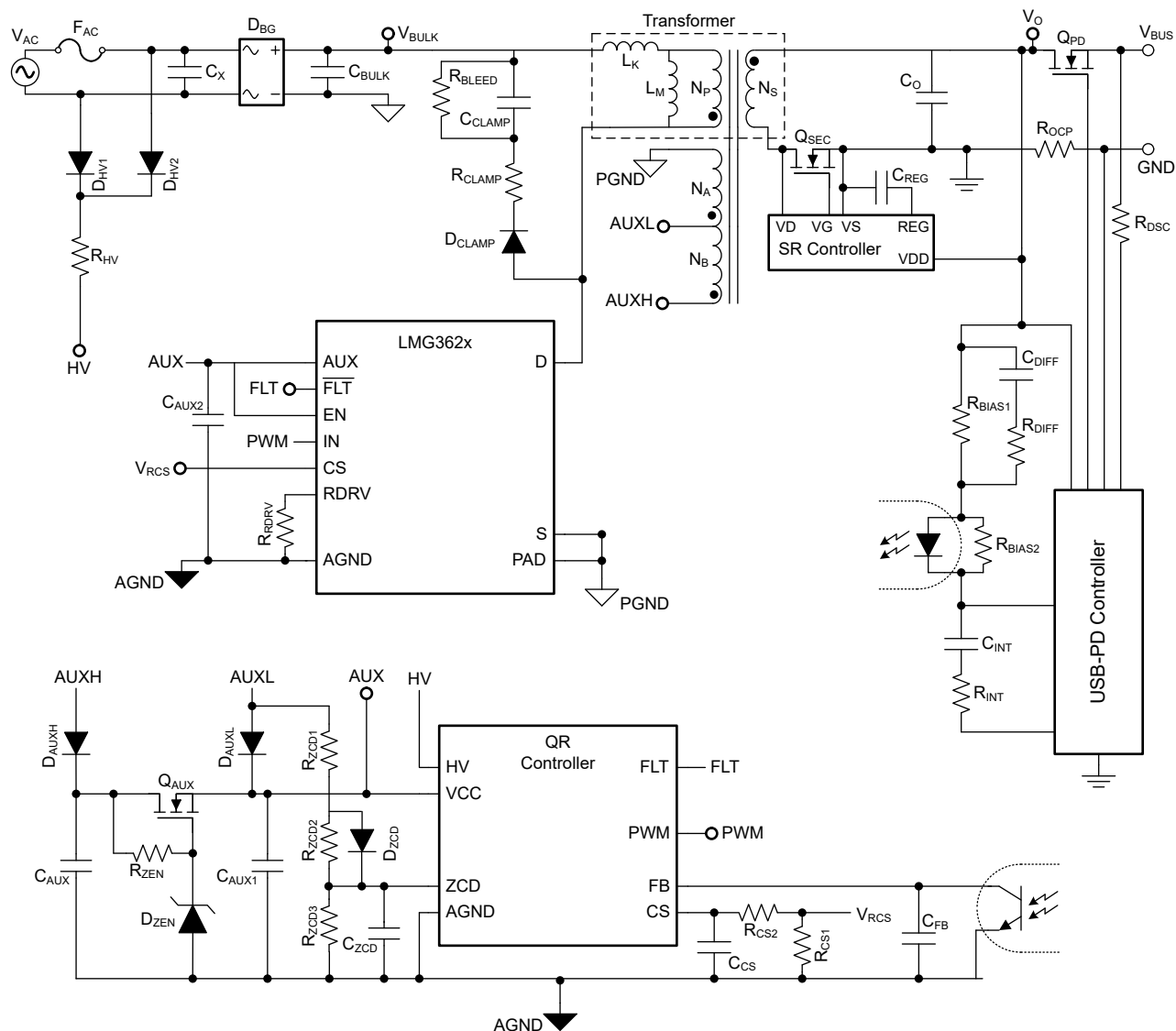


図 8-1. 65W USB PD チャージャ疑似共振フライバック コンバータ アプリケーション

8.2.1 設計要件

表 8-1. 設計仕様

仕様	値
入力 AC 電圧範囲	90VAC ~ 264VAC
ライン周波数範囲	47Hz ~ 63Hz
出力 DC 電圧設定	5V、9V、15V、20V
20V 出力定格電流	3.25A
5V、9V、15V 定格出力電流	3A
出力負荷なしでの最大 AC 入力電力	70mW
20V 出力および全負荷時の入力 AC 電圧範囲での最小効率	93%

8.2.2 詳細な設計手順

65W USB-PD チャージャ アプリケーションは、『[『LMG3626EVM-074 65W USB-C PD 高密度疑似共振フライバックコンバータ EVM の使用』](#)ユーザー ガイドに記載されている EVM 設計から取得したものです。疑似共振フライバックコンバータの設計全体は、ここには掲載していません。『[LMG362XX 疑似共振電力段設計カリキュレータ](#)』を使用して、特定用途向けコンバータ設計を作成してください。この詳細な設計手順では、アプリケーションで LMG3626 を使用する際の詳細を中心に説明します。

8.2.2.1 ターンオン スルーレートの設定

LMG3626 ターンオン スルーレートは、[セクション 7.3.2](#) で説明しているようにプログラムされます。設計上の検討事項は 1 つは、電源の効率と EMI または過渡リングングとのトレードオフです。ターンオン スルーレートが遅いと、EMI とリングングの問題が減少しますが、スイッチング損失が増加します (その逆も発生する可能性があります)。

通常の疑似共振フライバック コンバータ動作では、パワー スイッチは動作条件に応じて、ZVS の両方で動作する、また ZVS を使用しないバレー スwitchingを行います。バレー スwitchingは、トランス電流がゼロのときに発生します。したがって、疑似共振コンバータでは、スイッチング クロスオーバー損失は発生しません。唯一のスイッチング損失は、バレー スwitching中のスイッチ ノードの容量性損失です。したがって、ターンオン スルーレートがコンバータ損失に影響を及ぼすことはありません。これは、最も遅いターンオン スルーレート設定を使用していると考えられます。しかし、ターンオン スルーレート設定は、スイッチのターンオン遅延により、コンバータ損失に 2 次的な影響を及ぼす可能性があります。

疑似共振コントローラでバレー スwitchingをどのように実装されているかに応じて、スイッチのターンオン遅延によってパワー コンバータがバレーの後にスイッチングを行い、容量性スイッチング損失が増加する可能性があります。ターンオン スルーレートが低下するにつれて、スイッチのターンオン遅延が長くなるため、ターンオン スルーレートを遅くすると、電源損失が増加する可能性があります。疑似共振コントローラがスイッチのターンオン遅延を補償する場合、最も低速なターンオン スルーレート設定を使用しても、損失は発生しません。それ以外の場合は、スイッチング ノイズの問題とスイッチング損失間で設計の最適化を行う必要があります。

R_{DRV} を「ターンオン スルーレート制御」セクションに示されている推奨プログラミング抵抗値 (標準値) に設定して、ターンオン スルーレートをプログラムします。

8.2.2.2 電流センスの設計

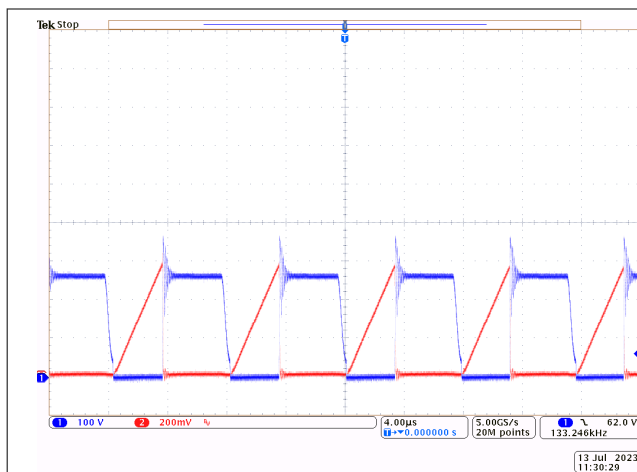
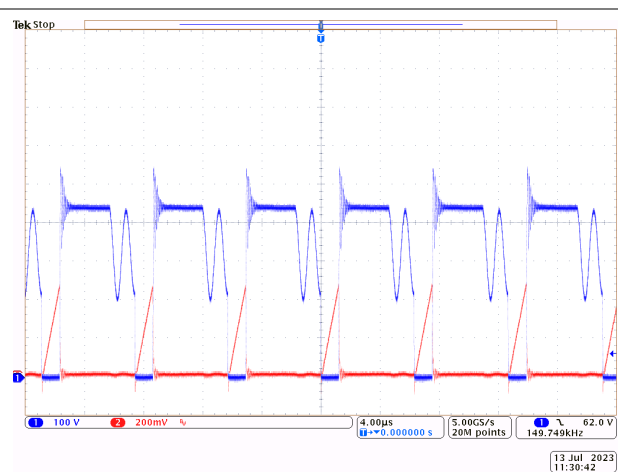
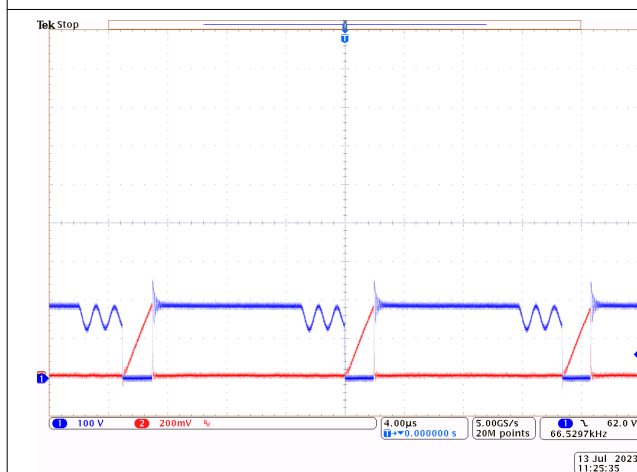
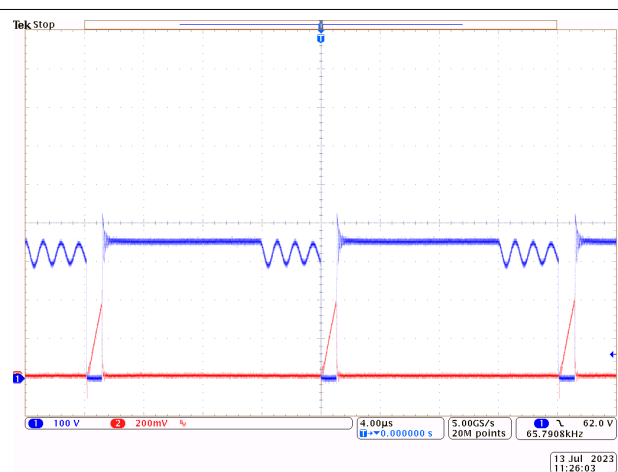
電流センス抵抗 R_{CS1} は、[セクション 7.3.3](#) セクションで説明されているように計算されます。従来の電流センス抵抗の設計計算を最初に実行し、電流検出エミュレーションの逆ゲインを乗算します。 $R_{CS(trad)}$ として表される従来の電流センス抵抗の設計での計算は、電流センス抵抗がパワー スイッチと直列に接続されており、パワー スイッチの全電流をセンシングする場合のものです。

$$R_{CS1} = 612 \times R_{CS(trad)} \quad (5)$$

R_{CS2} の存在は、疑似共振コントローラに依存しています。 R_{CS2} を使用する場合、 R_{CS2} の設計計算では、この値が非常に小さく、 R_{CS2} の計算に影響を与えない従来の電流センス抵抗を使用したと仮定する場合があります。 R_{CS2} の計算が R_{CS1} の大きな値を考慮していることを確認してください。

8.2.3 アプリケーション曲線

以下の波形は、代表的なスイッチング波形を示しています。青のパターンは LMG3626 ドレイン電圧 (スイッチ ノード電圧)、赤のパターンは CS ピン電流検出エミュレーション電圧です。

図 8-2. $V_{IN} = 115VAC$ $V_{OUT} = 20V$ $I_{OUT} = 3.25A$ 図 8-3. $V_{IN} = 230VAC$ $V_{OUT} = 20V$ $I_{OUT} = 3.25A$ 図 8-4. $V_{IN} = 115VAC$ $V_{OUT} = 5V$ $I_{OUT} = 3A$ 図 8-5. $V_{IN} = 230VAC$ $V_{OUT} = 5V$ $I_{OUT} = 3A$

8.3 電源に関する推奨事項

LMG3626 は、AUX ピンに接続された 1 つの入力電源で動作します。LMG3626 は、この電源コントローラが管理および使用すると同じ電源による動作をサポートしています。10V ~ 26V という広い推奨 AUX 電圧範囲は、一般的なコントローラの電源ピンにおける起動電圧および UVLO 電圧の制限値と重複します。

AUX 外部容量を、動作条件全体にわたって少なくとも $0.03\mu F$ のセラミック コンデンサにすることが推奨されます。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

8.4.1.1 半田接合部のストレス リリーフ

大型の QFN パッケージでは、はんだ接合部に高い応力がかかることがあります。半田接合部への応力を軽減するため、複数のベスト プラクティスが推奨されます。まず、「[ピンの機能](#)」に説明が記載されている NC1、NC2、NC3 アンカー ピンの指示に従ってください。第 2 に、[セクション 11](#) のランド パターン例に示すように、すべての基板溶剤 パッドは非ソルダーマスク定義 (NSMD) にする必要があります。最後に、NSMD パッドに接続される基板トレースは、接続されるパッド側でパッド幅の 2/3 未満にする必要があります。このトレースは、ハンダ・マスクで覆われていない間は、この 2/3 幅制限を維持する必要があります。トレースがハンダ・マスク下の場合、トレースの寸法に制限はありません。[セクション 8.4.2](#) は、これらの推奨事項すべてに従いました。

8.4.1.2 信号-グランド接続

信号グランドと電源グランドを別々にして、それらを 1 か所にもみ接続する電源を設計します。LMG3626 の AGND ピンを信号グランドに接続します。LMG3626 SL ピンとパッドのサーマル パッドを電源グランドに接続します。電源グランド接続は、AGND ピン、S ピン、PAD サーマル パッドを内部で接続するため、これは信号グランドと電源グランドとの間の単一接続点として機能します。以下で推奨されている場合を除き、信号グランドと電源グランドは、ボードの他の場所には接続しないでください。LMG3626 が取り付けられていない場合のボードデバッグを容易にするため、[セクション 8.4.2](#) に示すように AGND パッドを PAD サーマルパッドに接続してください。

8.4.1.3 CS ピン信号

[式 4](#) に示されているように、電流センス信号のインピーダンスは、従来の電流センス信号より 3 桁高くなります。このようにインピーダンスが大きいと、電流センス信号のノイズ感受性に影響します。ノイズの多いトレースの近くに電流センス信号を配線することは、最小限に抑えてください。電流センス抵抗とすべてのフィルタリング コンデンサは、トレースの右端に、コントローラの電流センス入力ピンの隣に配置します。

8.4.2 レイアウト例

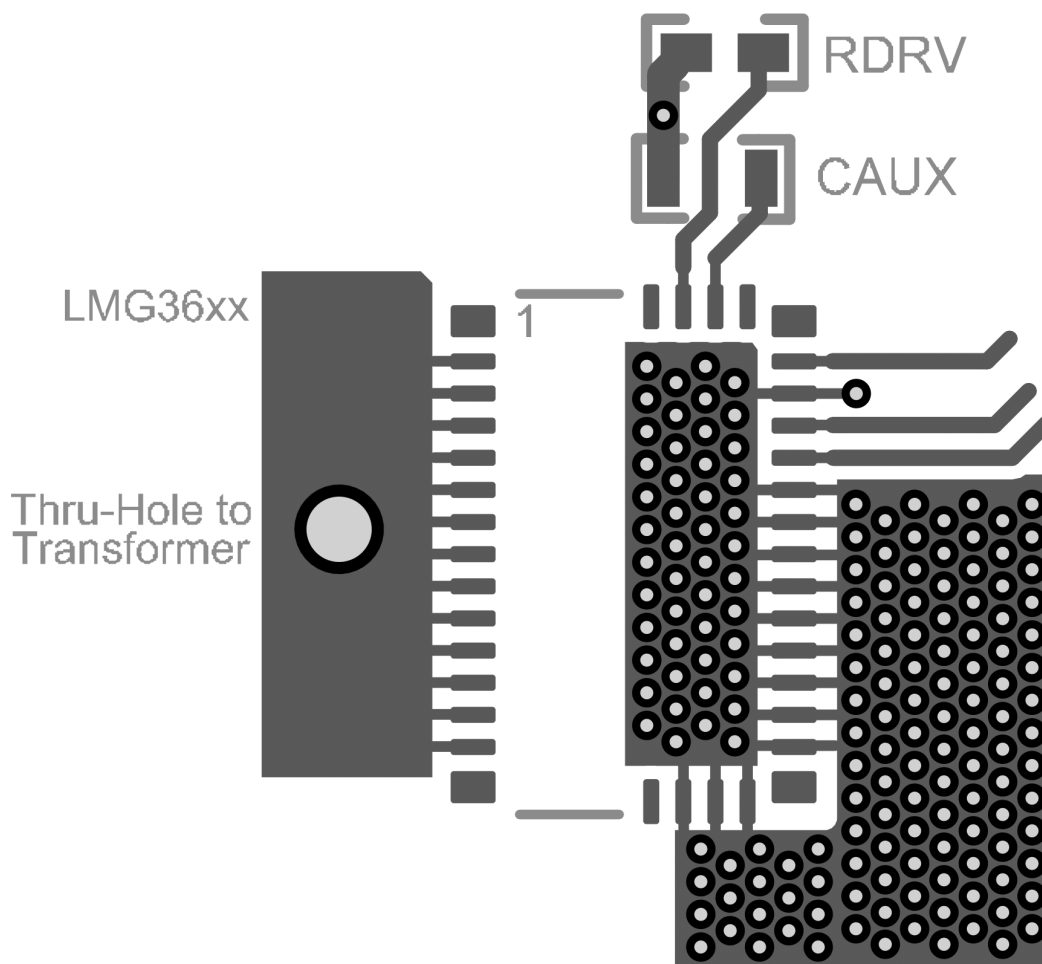


図 8-6. PCB 最上層 (最初のレイヤ)

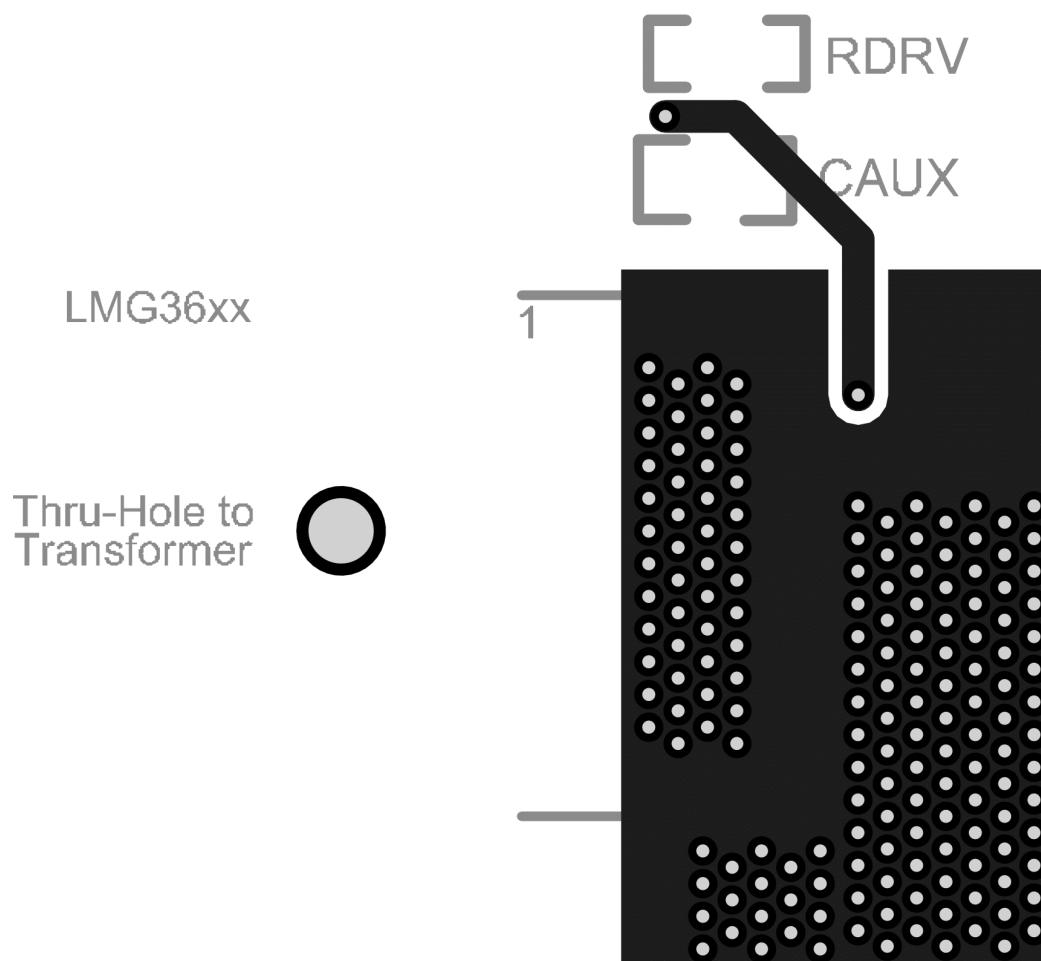


図 8-7. PCB 最下層 (2 番目のレイヤ)

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

- テキサス インスツルメンツ、[『LMG362XX 疑似共振電力段設計カリキュレータ』](#)
- テキサス インスツルメンツ、[『『LMG3626EVM-074 65W USB-C PD 高密度疑似共振フライバック コンバータ EVM ユーザーガイドの使用』](#)です。

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (November 2023) to Revision B (May 2025)	Page
• 電圧定格を 650V から 700V に、ドレイン ソース間オン抵抗を 270mΩ から 220mΩ に更新.....	1
• 「アプリケーション」セクションのテキストを更新。.....	1
• 脚注 (2) で電圧定格を更新し、「絶対最大定格」セクションに脚注 (3) を追加.....	5
• 「電気的特性」セクションの「GaN パワー FET」サブセクションに、25°C でのドレイン ソース間オン抵抗の最大値を追加し、25°C と 125°C でのドレイン ソース間オン抵抗の標準値を更新.....	5
• 「電気的特性」セクションの「過熱保護」サブセクションに、温度フォルト – 正方向スレッショルド温度の最小値を追加..	5
• 「代表的特性」セクションに、出力キャパシタンスとドレインソース間電圧との関係のグラフ、および出力キャパシタンスに蓄積されたエネルギーとドレイン ソース間電圧との関係のグラフを追加.....	10
• 図を更新し、『GaN パワー FET のスイッチング機能』セクションのアプリケーションの使用方法を明確化する文を追加	14

-
- 「レイアウト例」セクションの図を更新..... 23
-

Changes from Revision * (September 2023) to Revision A (November 2023)**Page**

-
- ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更..... 1
-

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

付録：パッケージ・オプション

パッケージ情報

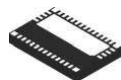
注文可能な型番	ステータス (1)	資料の タイプ (2)	パッケージ ピン数	パッケージ数量 キ ャリア	RoHS (3)	リード端子の仕上げ/ ボールの原材料 (4)	MSL 定格/ピークリフロ ー (5)	動作温度 (°C)	部品マーキング (6)
LMG3626REQR	アクティブ	量産出荷中	VQFN (REQ) 38	2000 大口径のテー プリール	ROHS 適用除 外	NiPdAu	レベ ル-3-260C-168HRS	-40～125	LMG3626 NNNNC
LMG3626REQR.A	アクティブ	量産出荷中	VQFN (REQ) 38	2000 大口径のテー プリール	ROHS 適用除 外	NiPdAu	レベ ル-3-260C-168HRS	-40～125	LMG3626 NNNNC
LMG3626ZREQR	アクティブ	量産出荷中	VQFN (REQ) 38	2000 大口径のテー プリール	ROHS 適用除 外	NiPdAu	レベ ル-3-260C-168HRS	-40～125	LMG3626 NNNNC SN3626

- (1) **ステータス:**ステータスの詳細については、TI の [製品ライフ サイクル](#) をご覧ください。
- (2) **資料のタイプ:**指定された量産開始前部品はプロトタイプ/検証用デバイスであり、実生産向けに承認またはリリースされたものではありません。テストおよび最終プロセス (品質保証、信頼性性能テスト、プロセス認証が含まれますが、これに限定されるものではありません) がまだ完了していない可能性があるほか、さらなる変更が加えられたり、中止される可能性もあります。注文可能になっている場合、その購入はチェックアウト時に新たな免責条項の対象となるものとします。また、これは早期内部評価のみを目的としたものです。これらの商品は、いかなる保証もなしで販売されています。
- (3) **RoHS 値:**はい、いいえ、RoHS 免除。詳細情報および値の定義については、[TI RoHS に関する声明](#) を参照してください。
- (4) **リード端子の仕上げ/ボールの原材料:**部品には複数の材料仕上げオプションがある場合があります。複数の仕上げオプションは、縦罫線で区切られています。リード端子の仕上げ / ボールの原材料の値が最大列幅に収まらない場合は、2 行にまたがります。
- (5) **MSL 定格/ピークリフロー:**湿度感度レベルの定格、および半田付けのピーク (リフロー) 温度です。部品が複数の耐湿性定格を持つ場合、JEDEC 規格で最低レベルのみを示しています。プリント基板に部品を取り付けるために使用する実際のリフロー温度については、出荷ラベルをご確認ください。
- (6) **部品マーキング:**ロゴ、ロットトレースコード情報、または環境カテゴリに関する追加マークが部品に記載されることがあります。複数の部品マーキングが括弧の中に記載されています。括弧内で「～」で区切られた 1 つの部品マーキングのみが部品に表示されます。行がインデントされている場合は、前行の続きということです。2 行合わせたものが、そのデバイスの部品マーキング全体となります。

重要なお知らせと免責事項:このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツルメンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツおよび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

いかなる場合においても、そのような情報から生じた TI の責任は、このドキュメント発行時点での TI 製品の価格に基づく TI からお客様への合計購入価格 (年次ベース) を超えることはありません。

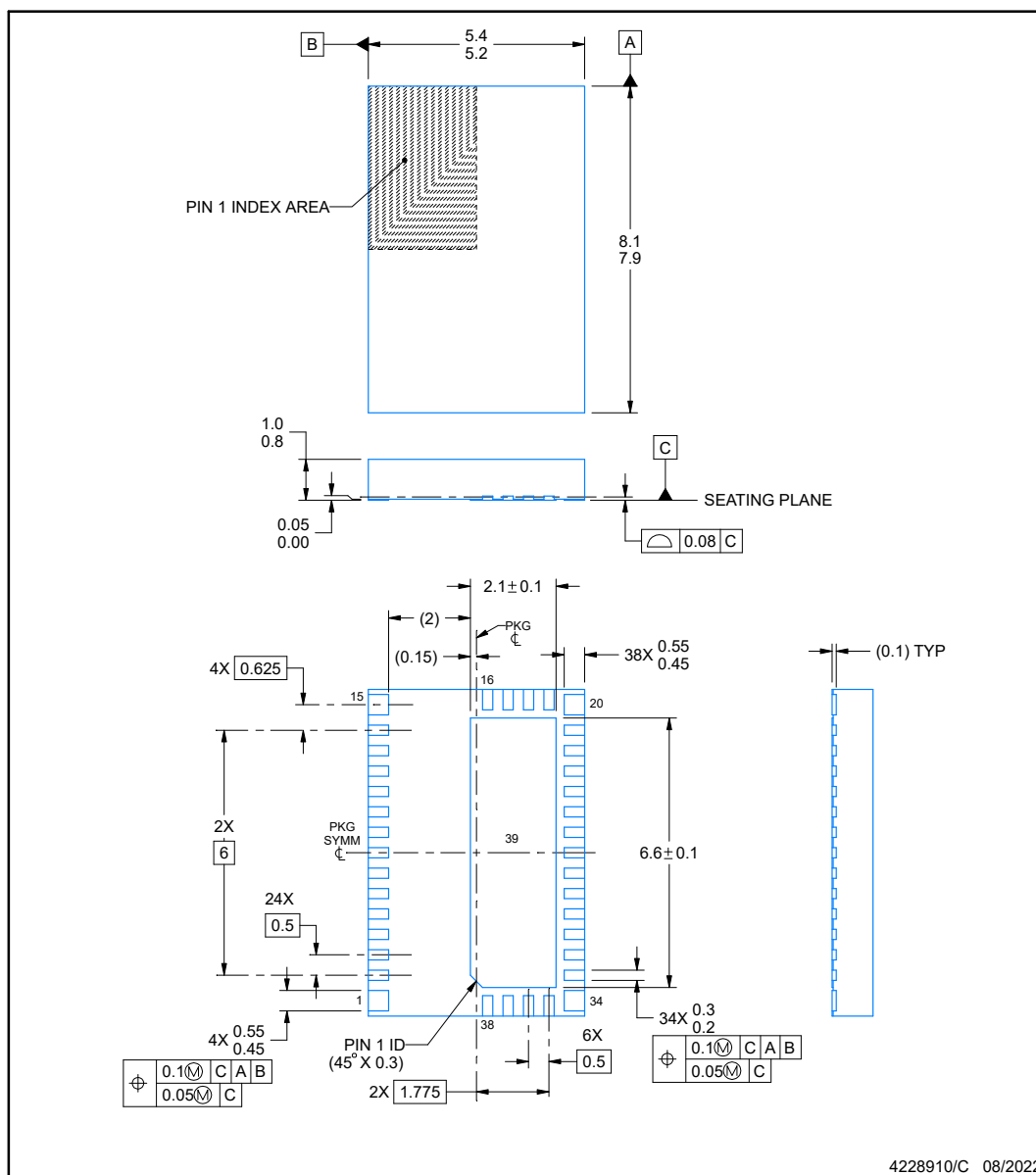
11.1 メカニカル データ



PACKAGE OUTLINE

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

REQ0038A

NOTES:

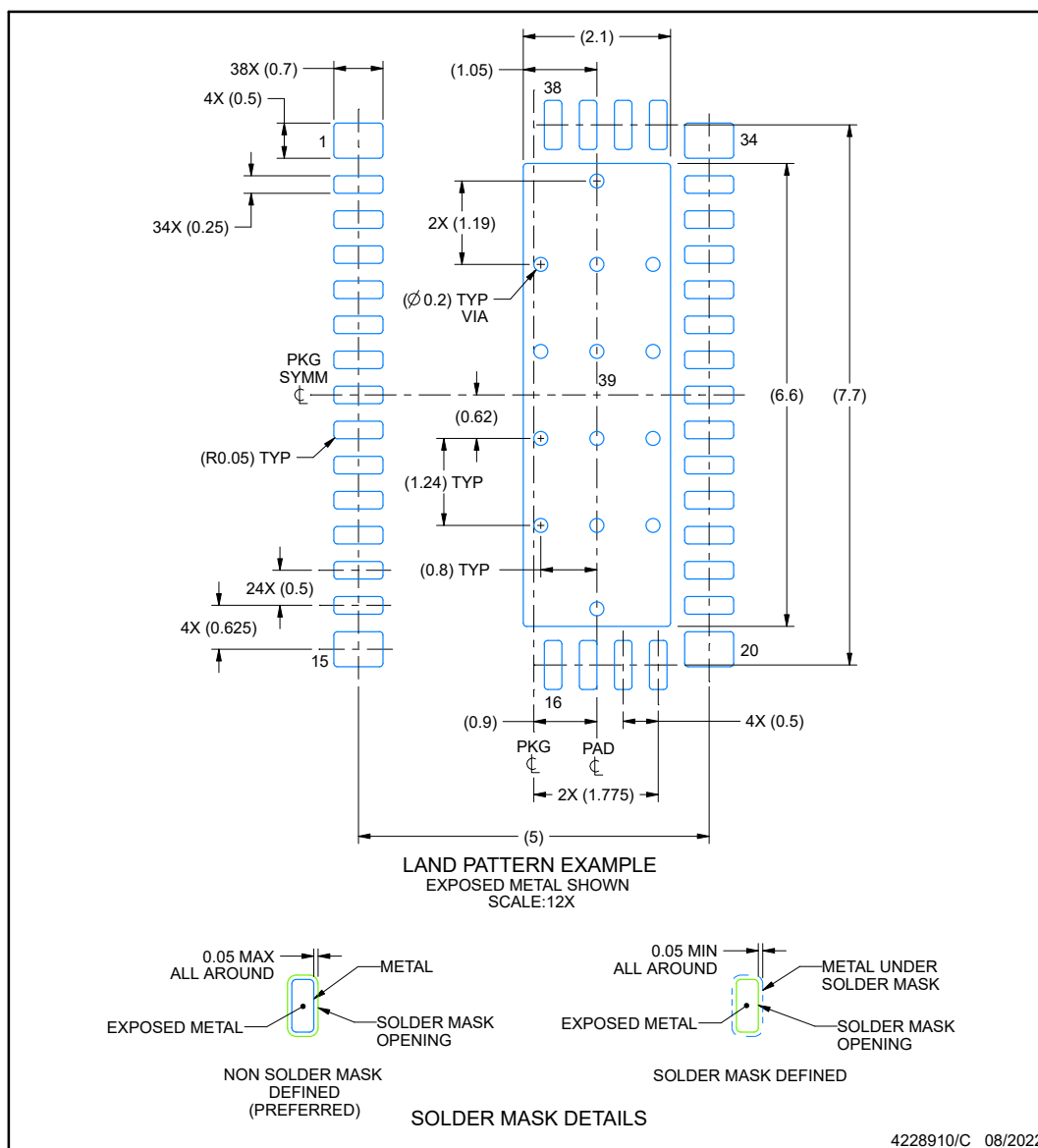
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

REQ0038A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

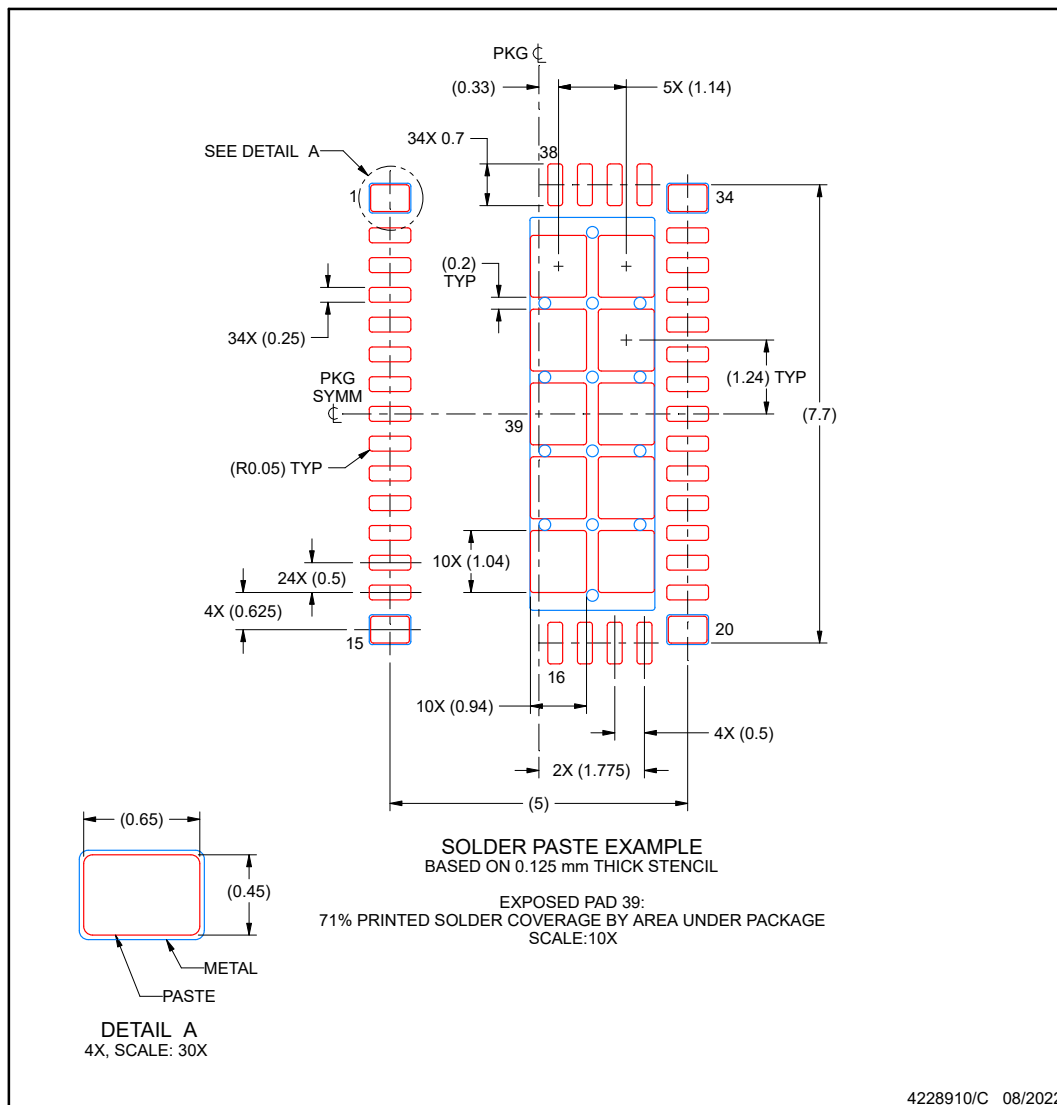


NOTES: (continued)

- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If some or all are implemented, recommended via locations are shown.

EXAMPLE STENCIL DESIGN**REQ0038A****VQFN - 1 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LMG3626REQR	Active	Production	VQFN (REQ) 38	2000 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-3-260C-168HRS	-40 to 125	LMG3626 NNNNC
LMG3626REQR.A	Active	Production	VQFN (REQ) 38	2000 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-3-260C-168HRS	-40 to 125	LMG3626 NNNNC
LMG3626ZREQR	Active	Production	VQFN (REQ) 38	2000 LARGE T&R	ROHS Exempt	NIPDAU	Level-3-260C-168HRS	-40 to 125	LMG3626 NNNNC

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

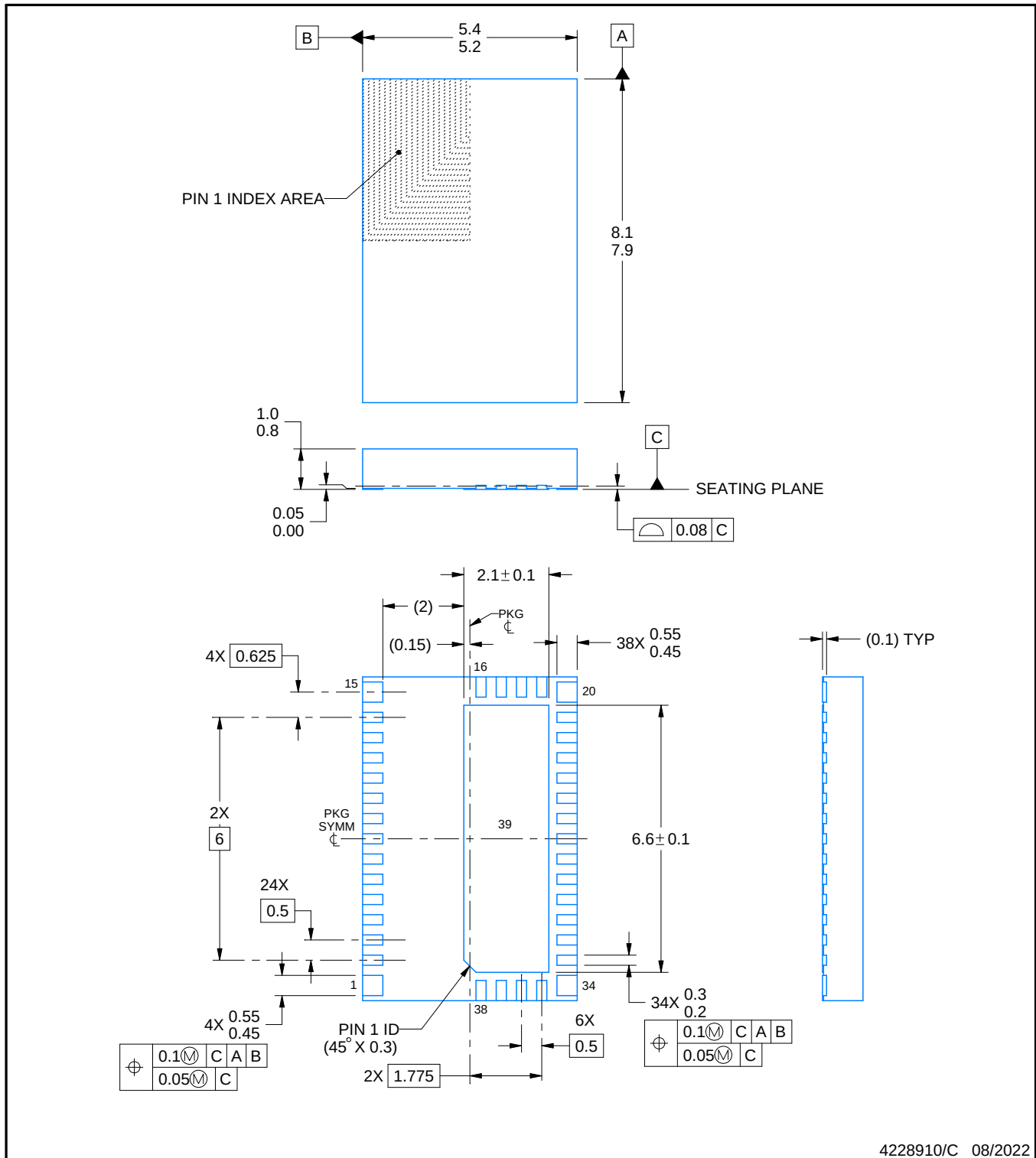
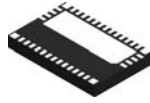
⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



4228910/C 08/2022

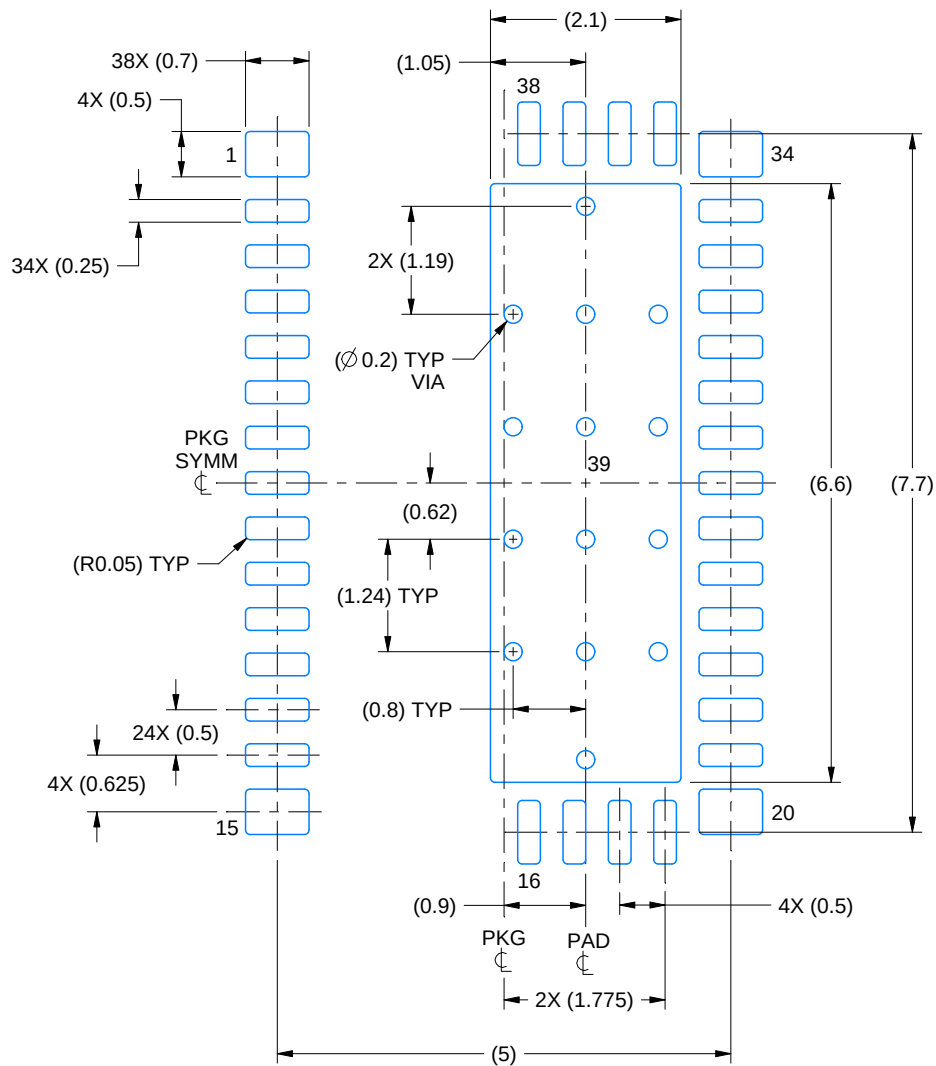
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

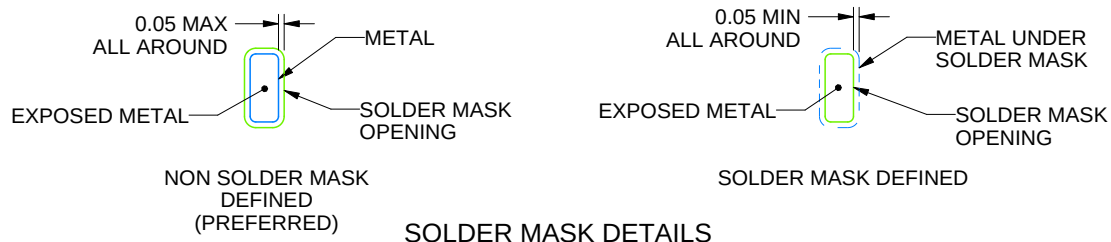
REQ0038A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:12X



4228910/C 08/2022

NOTES: (continued)

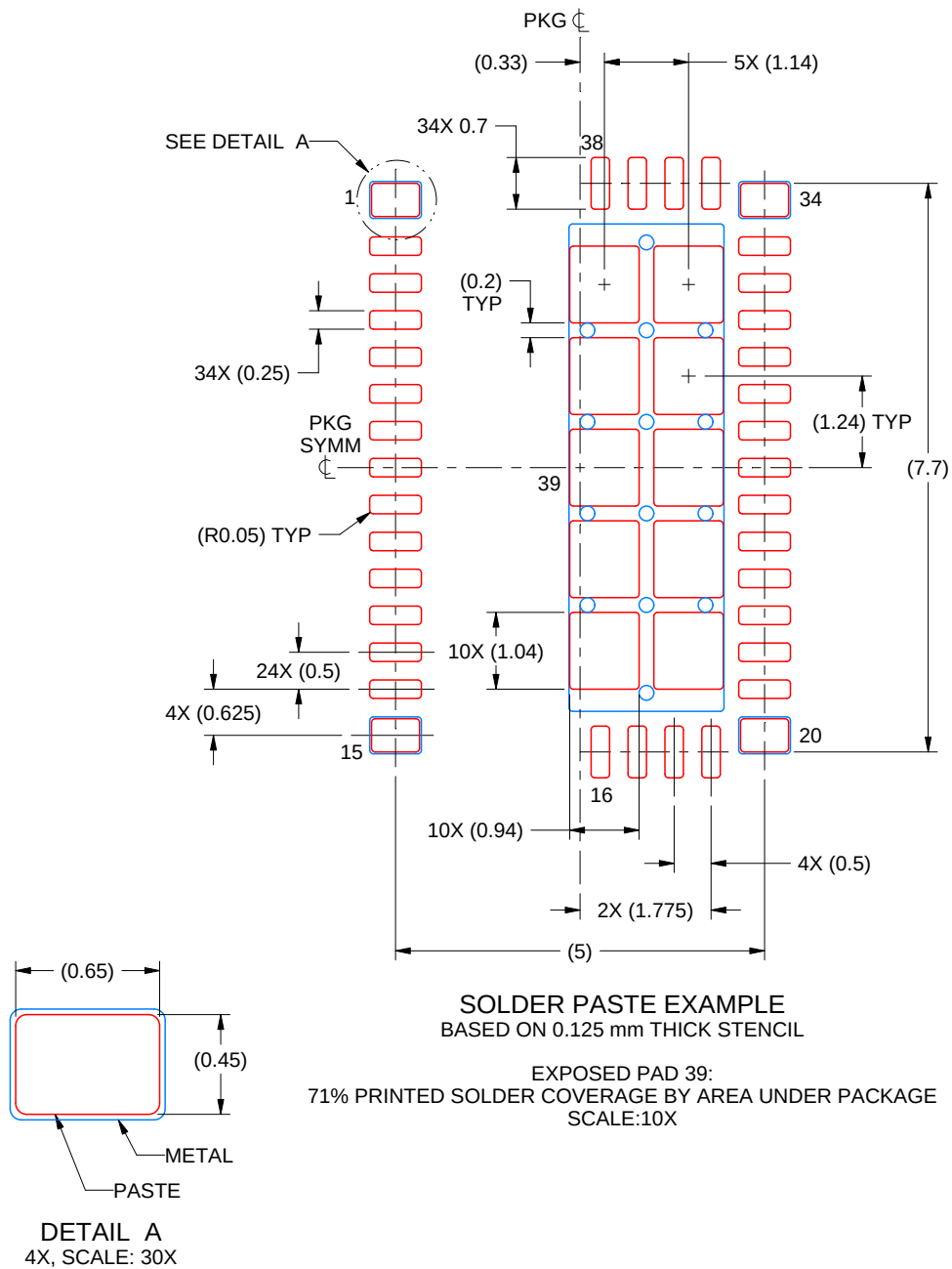
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If some or all are implemented, recommended via locations are shown.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

REQ0038A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4228910/C 08/2022

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月